

日商創造科學 發表TSV新製程技術

【新竹訊】日商ESC大廠—日商創造科學（Creative Technology）公司發表最新對應TSV等新製程所開發技術，包括靜電吸盤、吸附機構、Heater，以及客製化全系列ESC（Electric Static Chuck），並於前年成立在台分公司，提供快速又全方位服務，積極爭取國內半導體大廠合作，並提供完整ESC解決方案。

甫於2008來台成立辦事處の日商創造科學公司，於SEMICON展世貿1館B332攤位展出系列半導體設備零件，展出包括TSV新的製程技術與各式ESC，歡迎前往指教。

日商創造科學海外營業部長清水隆行表示，該公司強調客製化的服

務流程，從產品的研發設計到製作中期與後段測試工程均完整涵蓋，提供雙極性靜電吸盤、加熱器、晶

圓承載盤、相關零件與離子植入設備耗材等，並提供各種材料加工、表面處理、黏合與評估測試服務，



●日商創造科學海外營業部長清水隆行（左）與業務代表陳思樑（右）為台灣區分公司主要窗口，該公司位於B332攤位展出系列半導體設備零件，展出包括TSV新的製程技術與各式ESC，歡迎前往指教。圖文／鍾旭昶

Confidential